



Feature 特点

- 无卤素 Tg(DSC) 185°C低损耗产品
- 优良耐热性能
- 优良通孔可靠性
- 优良耐CAF性能
- Halogen-free Tg(DSC) 185°C High Speed Low Loss Product
- Excellent Thermal Resistance
- Excellent PTH Reliability
- Excellent Anti-CAF Performance

Application 应用

- 交换机、服务器、路由器、通讯设备、汽车等
- Switch, Server, Router, Communication Equipment, Automotive etc.

Feature 特点

Base Color 基板颜色	Thickness 厚度	Copper Thickness 铜箔厚度	Regular Size 常规尺寸
Yellow 黄色	0.03~4.0 mm	Toz~4oz	2082*1245m (82*49) 1092*1245mm (43*49) 2184*1245m (86*49)

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.
可根据客户要求提供其他尺寸和厚度

General Properties 一般特性

测试项目 Test Item	单位 Unit	测试方法 Test Condition (IPC-TM-650)	处理条件 Treatment Condition	规格值 Specification	典型值 Typical Value
玻璃态转化温度 Tg(DSC)	°C	2.4.25	E-2/105	≥170	185
剥离强度(35um) Peel Strength	N/mm	2.4.8	热应力后 (Float 288°C/10sec)	/	0.9
热应力(288°C) Thermal Stress	Cycle	2.4.13.1	未蚀刻	≥60	>400
介电常数(RC50%) Permittivity	10GHZ	-	C24/23/50	≤4.2	3.8
介质损耗(RC50%) Loss Tangent	10GHZ	-	C24/23/50	≤0.015	0.007
体积电阻率 Volume Resistivity	MΩ-cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁶	5x10 ⁸
表面电阻率 Surface Resistivity	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁴	4.3x10 ⁷
电气强度 Electric Strength	KV/mm	2.5.6.2	D-48/50+ D-0.5/23	≥30	50
耐电弧性 Arc Resistance	SEC	2.5.1	D-48/50+ D-0.5/23	≥60	180
击穿电压 Dielectric Breakdown	KV	2.5.6	D-48/50+D-0.5/23	≥40	55
弯曲强度 Flexural Strength	LW经向	N/mm ²	常态A	≥415	532
	CW纬向			≥345	453
吸水率 Water Absorption	%	2.6.2.1	D-24/23	≤0.5	0.1
Z轴膨胀系数 CTE Z-Axis	Before Tg, TMA	ppm/°C	E-2/105	≤60	42
	After Tg, TMA	ppm/°C		≤300	120
	50~260°C	%		≤3.0	1.8
热分层时间 Thermal stratification	T260	min	蚀刻, E-2/105	≥30	>60
	T288去铜	min		≥5	>60
热分解温度 Td	Weight Loss 5%	°C	E-2/110	≥340	380
燃烧性E Flammability	Rating	UL94	E-24/125+DES	V-0	V-0
相对漏电起痕指数 CTI	-	IEC-60112	常态A	PLC 3	PLC 3

Specification sheet: IPC-4101/130, for reference only.